

2026年3月期 決算説明資料



日本高純度化学株式会社

証券コード：4973

2026年4月24日





決算の概況



(注) 当社業績の見方のポイント

- 売上高は、薬品と一緒に貴金属を販売する場合と、薬品のみを販売する場合によって大きく変動します。
- 貴金属は価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。

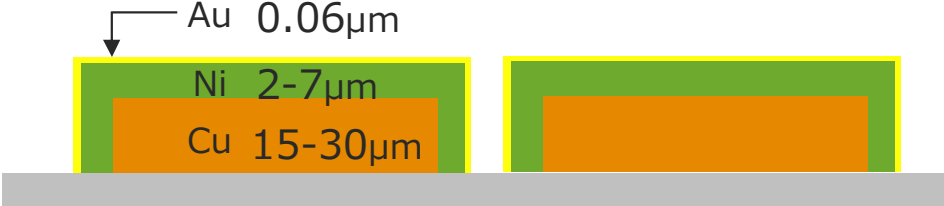
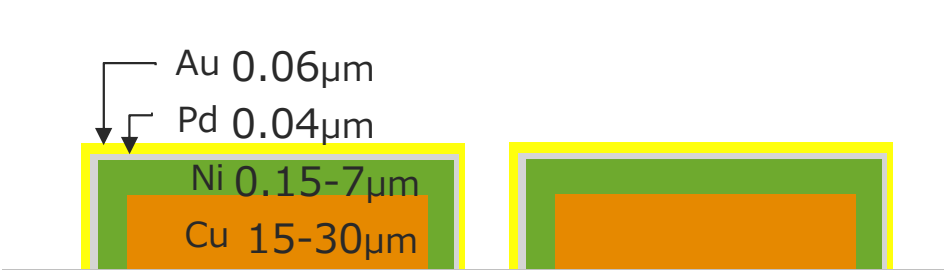


めっき方式の説明

用語	最終用途	説明
電解めっき	—	金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	PC・スマホ等のプリント基板（CPU・GPU等）	高純度な純金めっき
硬質金めっき	スマートフォン・車載・産業機械等のコネクタ	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウムめっき	PC・車載・産業機械等のリードフレーム	金めっきの下地めっきとして使用される
無電解めっき	—	電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換金めっき	DRAM・NAND等の半導体メモリ サーバ・PC・スマートフォン等の半導体 パッケージ基板	金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元金めっき	半導体パッケージ基板 サーバ・PC等のCPU・GPU等	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法
還元パラジウムめっき	サーバ・PC等の半導体パッケージ基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法（金めっきの下地として使用される）

製品ラインアップ

めっき方式		用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	テンペレジストシリーズ
	硬質金		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき	オーロブライト BAR7
	パラジウム		PPF用薄膜パラジウムめっき (PPF: Pre Plated Lead frame)	パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき	IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN IM-GOLD PC
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	HY-GOLD HY-GOLD CN
	還元パラジウム		ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき	ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP
周辺分野			卑金属（銅、スズ、ニッケル）、合金めっき、後処理剤など	

めっきプロセスの説明

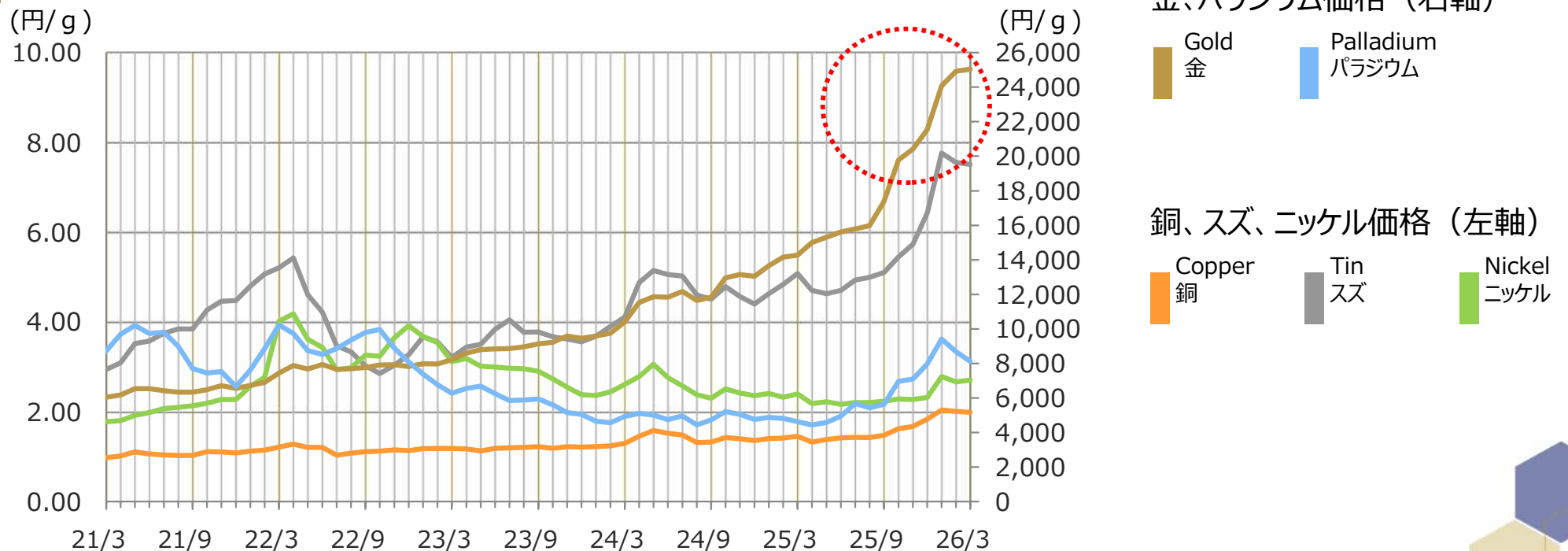
用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Ni-Au Electroless Nickel Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06μm Ni 2-7μm Cu 15-30μm</p>
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法 薄ニッケル化の動きが進んでいる。 層構成はCu-Ni-Pd-Au Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06μm Pd 0.04μm Ni 0.15-7μm Cu 15-30μm</p>
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。 層構成はCu-Au Direct Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06μm Cu 15-30μm</p>
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Pd-Au Electroless Palladium Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06μm Pd 0.04μm Cu 15-30μm</p>

2026年3月期 外部環境

電子部品業界の状況

- ハイパースケーラーによるAIインフラ投資の拡大を背景に、AIサーバーおよびデータセンター向け需要が大きく伸長。パソコン向けは着実に回復した一方、スマートフォンなどの民生機器およびFA機器等の産業機器向けは緩やかな回復にとどまる。
- 車載用電子部品については、米国の関税措置や欧米の電気自動車政策見直し、中国の内需減速の影響を受けたものの、ADAS（Advanced Driver Assistance Systems）やSDV（Software Defined Vehicle）の普及が一定程度下支えし、足元では持ち直しの動きも見られた。

貴金属の概況



2026年3月期 決算概況

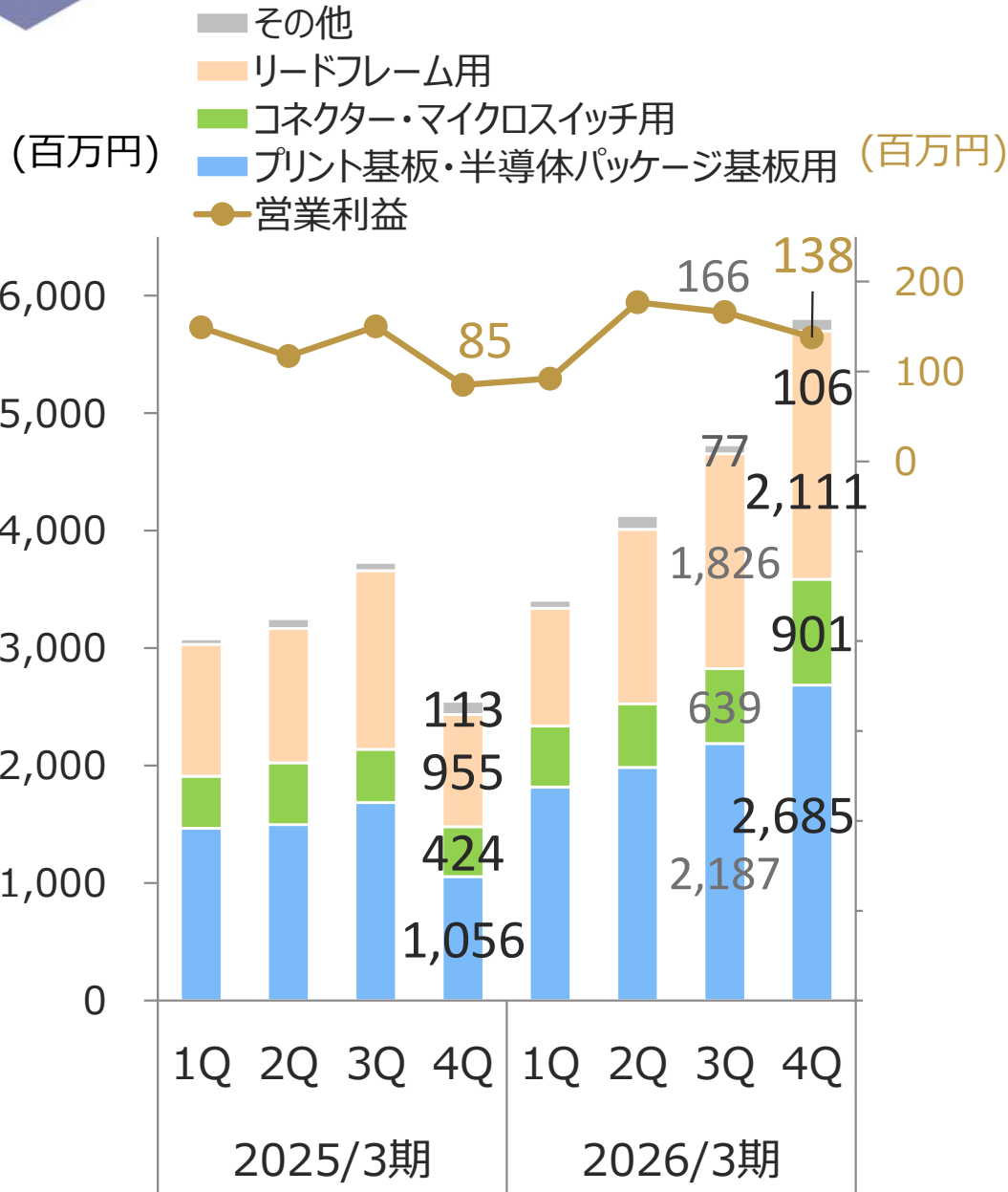
当社の決算概況：増収増益

- 売上高：スマートフォンやパソコンなど民生向け需要が回復基調で推移したことに加え、生成AI関連需要の拡大を背景に、半導体パッケージ、モジュール、およびメモリ向けの販売も堅調に推移加えて貴金属価格の上昇の影響もあり、前年比+43.3%の増収
- 営業利益：新規拡販・販売量増加による粗利の増加により、研究開発等への先行投資に伴う費用増を吸収し、前年比+14.7%の増益
- 当期純利益：営業利益の増加に加え、前年度を上回る政策保有株式の売却益の計上により、前年比+14.2%の増益

(単位：百万円)

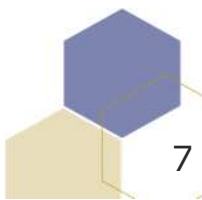
	2025/3期 通期	2026/3期						
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期	増減率	26/1公表比
	売上高	12,611	3,406	4,129	4,730	5,806	18,073	+43.3%
営業利益	502	92	178	166	138	576	+14.7%	106.7%
経常利益	657	184	193	242	155	776	+18.0%	106.3%
四半期純利益	1,579	135	489	810	369	1,803	+14.2%	103.1%
1株当たり 四半期純利益	273.73円	23.40円	84.60円	140.00円	63.78円	311.86円	-	-

売上高・営業利益の推移



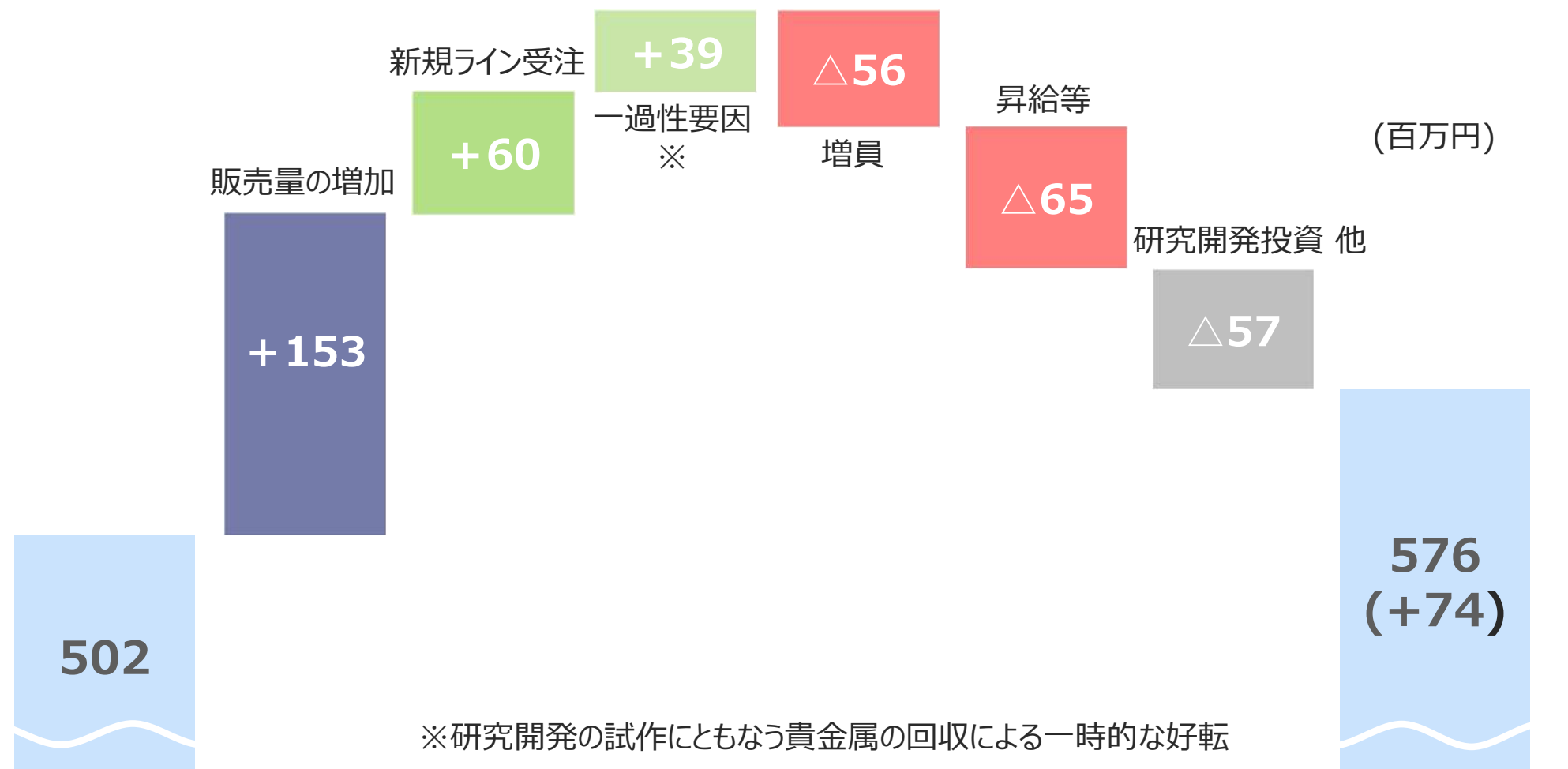
カテゴリー別概況（通期）

- **プリント基板・半導体パッケージ基板用めっき薬品**
スマートフォンやパソコンなどの民生向け需要が回復基調で推移したことに加え、生成AI関連の半導体パッケージ、光通信モジュールおよびメモリ向けが堅調に推移し、貴金属価格の上昇も影響し増収
- **コネクター用めっき薬品**
車載向けで足踏み感が見られたが、スマートフォン向けおよび産業機器向けの回復により増収
- **リードフレーム用めっき薬品**
民生向けが堅調に推移したことに加え、貴金属価格の上昇の影響もあり増収



営業利益増減要因（前年同期比）

- 需要回復にともなう販売量の増加の他、AIサーバー関連等の新規ライン受注拡大が増益に寄与
- 人的資本への先行投資の継続と研究開発投資による費用増を吸収し、増益を達成

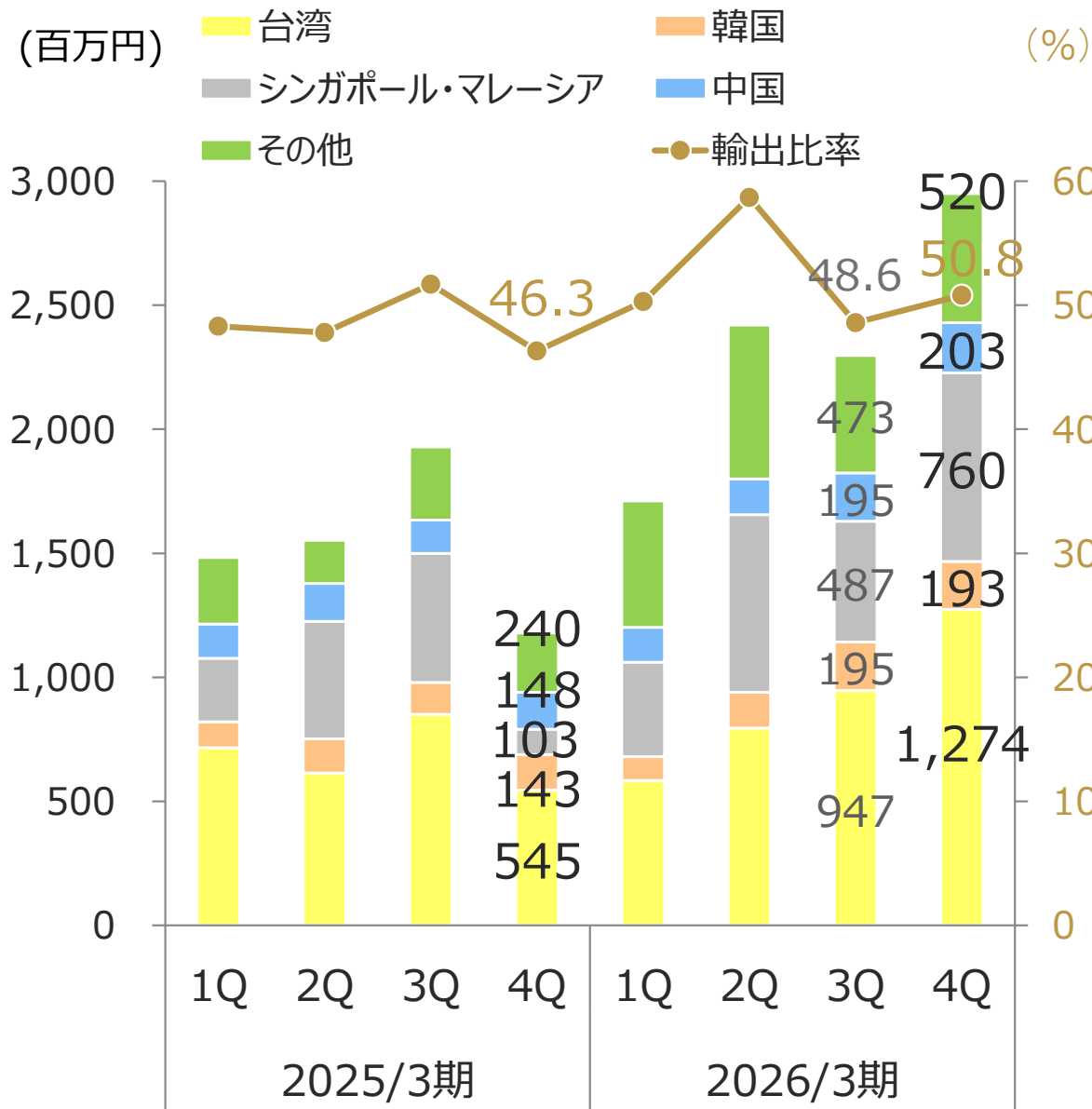


2025年3月期
営業利益

注) 当社は為替予約により為替変動の影響を最小限に留めています

2026年3月期
営業利益

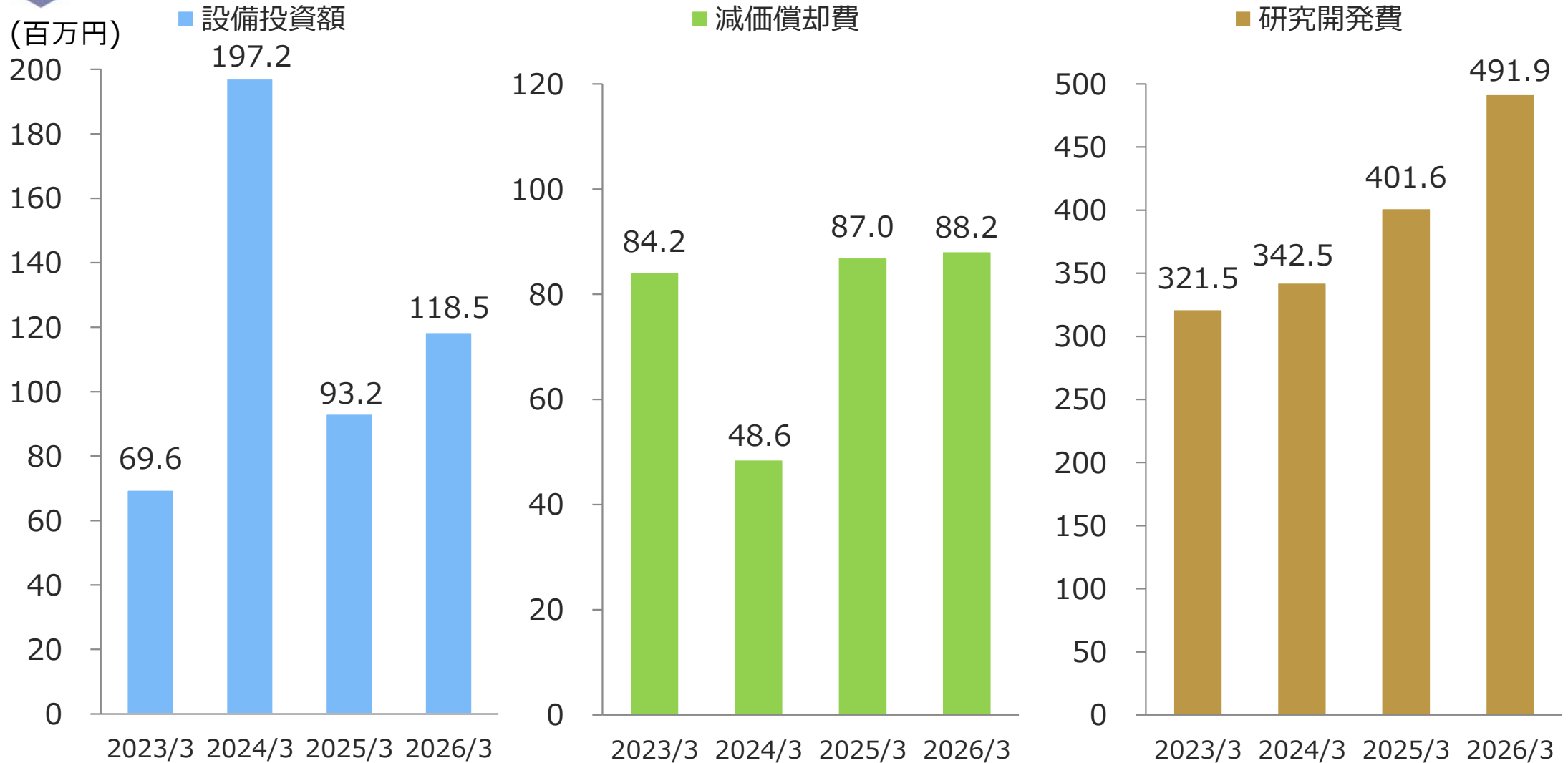
輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



増減理由（通期）

- 台湾
AIサーバ向け光通信モジュールおよび民生向けリードフレーム用途が堅調に推移し、貴金属 価格の上昇も背景に増収
- シンガポール・マレーシア
民生・産業機械向けのリードフレームが回復基調で、パソコン/サーバ向けパッケージ用途も堅調に推移し、貴金属 価格の上昇も背景に増収
- その他
フィリピンにおけるパソコン/サーバ向けパッケージ用途の需要増

設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移



- 2026/3期の主な投資 : ICP分析装置 18百万円、J-PLAT 18百万円
- 2027/3期の主な投資予定 : 研究開発設備・製造設備レイアウト変更 100百万円
液体クロマトグラフ質量分析計 30百万円

2027年3月期 見通し

- AI需要の拡大によりメモリー生産がAI向けに優先され、非AI向けへの供給制約が見込まれるものの、引き続きAIサーバー／データセンターおよびハイエンドスマートフォン向けが牽引し、産業機械向け基板・コネクタの回復と高水準の貴金属価格を背景に増収増益を見込む
- 新材料向けめっき薬品および電池材料の開発を軸に、研究開発活動の一層の強化を図る
- 前年度を上回る株式売却益を織り込み最終増益を見込み、年間配当を1株当たり230円に増額
- 中東情勢等に伴う原材料価格の高騰や調達リスクの影響は現時点では未織込

(単位：百万円)	2026/3期	2027/3期	前期比
	売上高	18,073	24,000
営業利益	576	610	+5.8%
経常利益	776	800	+3.1%
投資有価証券売却益	1,655	2,100	+26.8%
当期純利益	1,803	2,170	+20.3%
1株あたり配当	200円	230円	+30円
ROE	11.5%	12.1%	—

政策保有株式売却の進捗

- 当社は政策保有株式について、中期経営計画 FY2025-2027の期間中に純資産割合を20%未満に縮減する方針を掲げています。
- 2026年1月26日公表の「投資有価証券売却益（特別利益）の計上見込みに関するお知らせ」のとおり追加的な売却を実施するなど、期初の計画を上回る売却を進めたものの、保有銘柄の株価が想定を大きく上回って上昇したことにより、結果として保有株式の時価は前年度末から増加しました。
- 2026年度は期初予想に前年度を上回る株式売却益を織り込みつつ、目標に向けた売却を計画的に推進してまいります。

	2025/3	2025年 6月末	2025年 9月末	2025年 12月末	2026/3	2025/3比
売却額 ※（百万円）	1,722	—	493	933	1,742	19増
保有株式時価（百万円）	5,974	6,740	8,416	9,308	10,743	4,769増
純資産額（百万円）	13,594	13,891	15,566	16,659	18,064	4,470増
純資産に対する割合（%）	43.9	48.5	54.1	55.9	59.5	15.6pt増

※ 2025年9月末および12月末の数値は当該四半期における売却額

株主還元の拡充

- 中期経営計画2025-2027において掲げている財務方針における株主還元方針に沿って行う配当を前年度比+30円増額し、年230円/株の配当を計画
- 政策保有株式の時価上昇と売却進捗を踏まえ、株式流動化に関する想定収入増は戦略投資ならびに株主還元に充てる

Cash-Out

(億円)	FY25-27	通常	成長投資		FY25-27 (25/4公表)
既存事業の成長に向けた投資 既存ビジネスの成長: インフラ強化、拡販投資	5	5	-		5
戦略投資枠の設定 ・アライアンス、協業、事業提携、M&A等 ・技術施設（開発 & 製造）の拡張・増強 ・電池材料関連のR&D（出資・CVC等を含む）	65~75 10~20 5~20	-	65~75 10~20 5~20	本中計期間内の実現に向けた戦略投資・ファシリテイに関する投資枠 +15追加	50~60 10~20 5~20
安定した株主還元 配当や自社株買い	65~70	20~25	45	政策保有株式の縮減にともなう収入の過半を株主に還元 +30追加	35~40
計	150~190	25~30	125~160		105~145
通常オペレーションによる営業CF	25~30	25~30	-		25~30
運転資金を超過した現預金	35~45	-	35~45	高水準の現預金を調整	35~45
政策保有株式の流動化	70~75	-	70~75	本中計期間内に純資産割合20%未滿まで縮減	25~30
外部からの資金調達	20~40	-	20~40	必要に応じて戦略投資等へ充当	20~40

Cash-In

トピックス1: フロア再編について – 成増オフィス新設ほか –

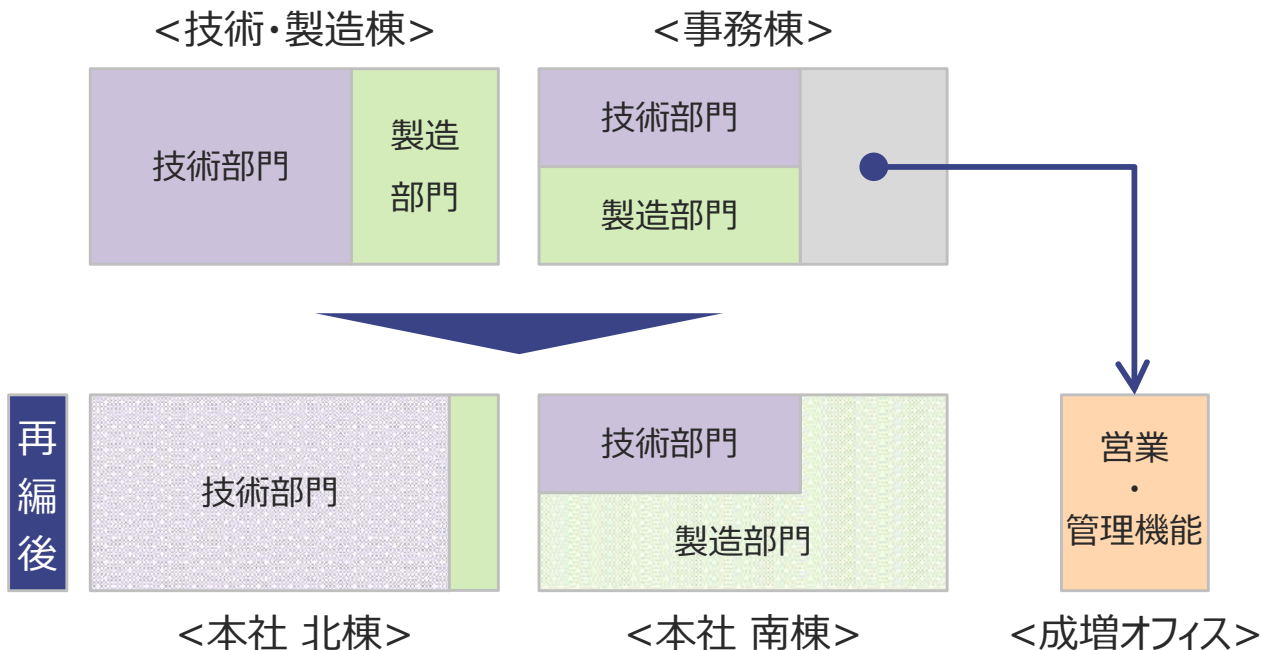
- 業容拡大にともなう本社の技術・製造フロアの再編（増床・効率化）や、営業活動の効率化を目的として、営業・管理機能を担う新オフィスを板橋区成増に開設 [2026年3月2日～業務開始]

📍 東京都板橋区成増1-30-13（成増トーセイビル4F）

東京メトロ副都心線・有楽町線 地下鉄成増駅 徒歩1分
東武東上線 成増駅 徒歩5分

- 現社屋（練馬区）の技術・製造フロア再編を実施中 [2026年2Q完了予定]

フロア再編（イメージ図）



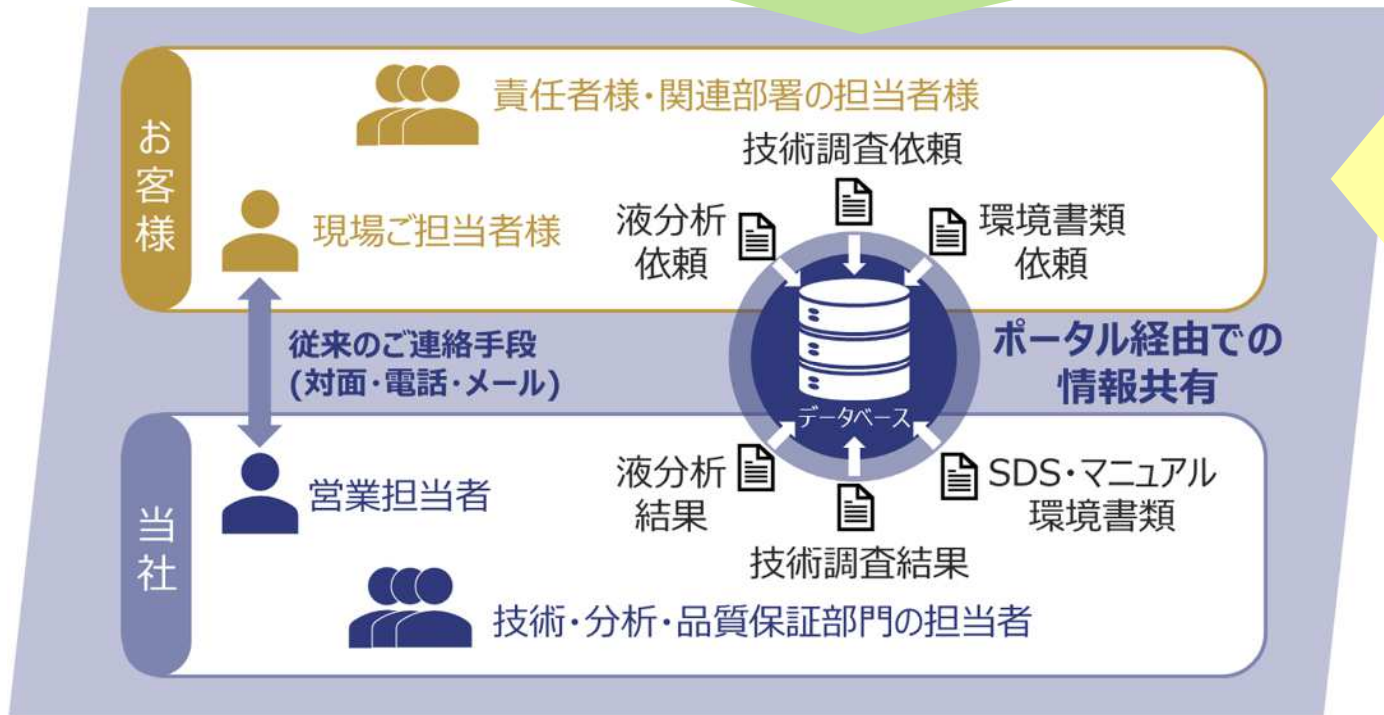
トピックス2: ポータルサイト「J-PLAT*」の展開状況

*商標登録出願中



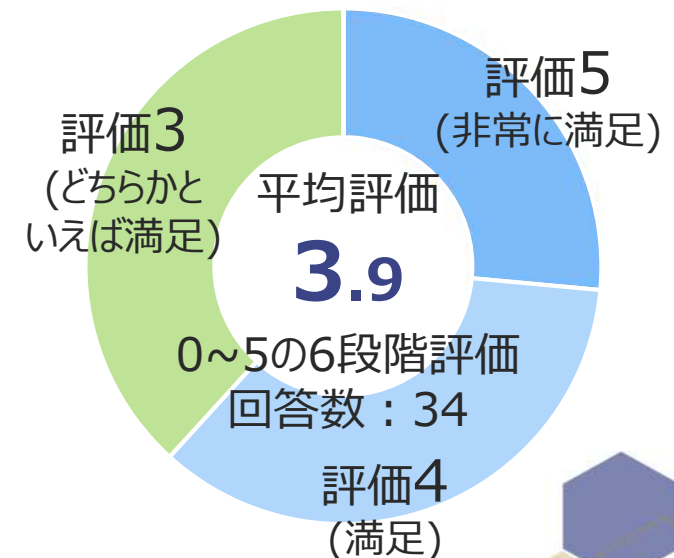
めっき技術に関する情報を統合した専用ポータルサイト

分析結果や技術資料を一元管理し、迅速かつ円滑な情報共有を実現することで、技術サポートの高度化と業務効率の向上に貢献



- ・国内外50社に導入済
- ・20,000件以上のデータを蓄積
- ・お客様アンケートにおいても高評価

お客様アンケート結果



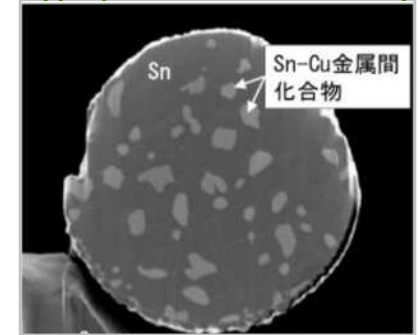
今後も機能拡充を通じ、利便性と付加価値の向上を推進してまいります

トピックス3: パワー半導体向け次世代接合めっき技術の開発

背景

- データセンター電力需要の増加を背景にパワー半導体市場は拡大
- パワー半導体はSiからSiC・GaNへの材料転換が進行
- 従来の接合材料(はんだ)は高温耐性や信頼性の面での課題多い

IMC材料の断面図
((有)ナプラ社特許取得材)



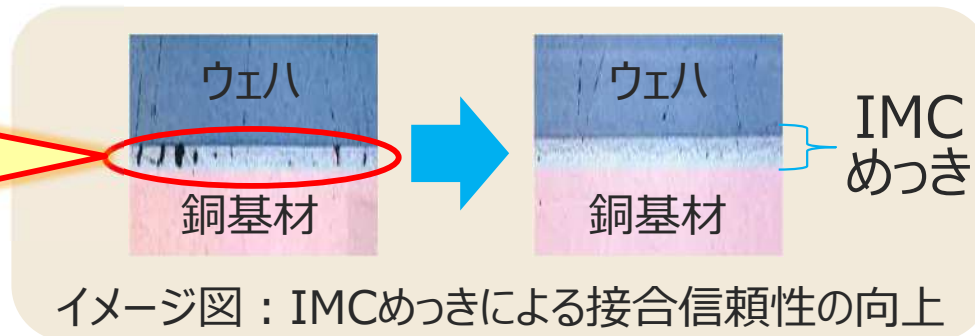
接合材料の抱える課題
(鉛フリー、Au系、Ag系はんだ)

- ✓ 耐熱性に限界があり、性能を十分に引き出せていない
- ✓ 代替候補である高融点はんだ(鉛含有)や銀ペーストは、環境負荷・コスト面のハードル高い

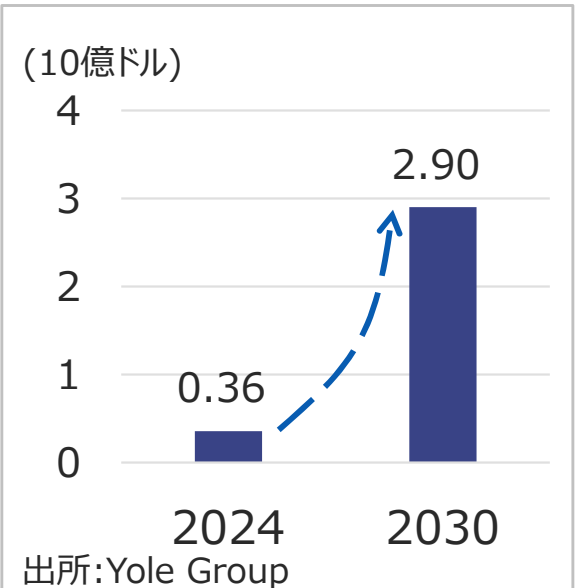
IMC*材料の特徴

- 金属間化合物の接合構造を制御することによる高信頼性
- 高温・低温環境下における安定性 (-45℃~175℃)
- 貴金属不使用、鉛不使用、スズと銅がベース

高温下におけるはんだ部分へのクラック・ボイド等の不良の発生



GaNパワーデバイス市場規模



材料技術をコアとする大手電子部品メーカーのIMC材料を用いた、次世代接合材料の革新的めっき液の開発を進めております。

* 特定の原子比で結合した化学的化合物 (Intermetallic Compound)

補足資料：会社紹介

沿革

- 1971年7月 会社設立
- 1999年11月 MBOを実施
- 2002年12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年3月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年2月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年4月 東京証券取引所プライム市場に移行
- 2026年3月 成増オフィス開設

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを保有しないファブライツ企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2026年3月末時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>